

# ICEPT2020

21st International Conference on Electronic Packaging Technology

August 12~15, 2020

Guangzhou, China

## 第二十一届电子封装技术国际会议(ICEPT 2020)

2020年8月12日-15日, 中国-广州

### 会议通知



第二十一届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2020) 将于 2020 年 8 月 12 日至 15 日在中国广州举行。会议由中国科学院微电子所、国际电气电子工程师协会电子封装学会 (IEEE-EPS) 和中国电子学会电子制造与封装技术分会 (CIE-EMPT) 主办, 广东工业大学承办, 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司协办。作为国际上最著名的电子封装技术会议之一, 会议得到了 IEEE-EPS 的全力支持和中国电子学会、中国科协的高度评价, 已成为国际电子封装领域四大品牌会议之一。当前, 摩尔定律已出现拐点, 半导体制造技术面临挑战, 新技术不断涌现。本会议将为来自海内外学术界和工业界的专家、学者和研究人员提供电子封装与制造技术新进展、新思路的学术交流平台。

电子封装技术国际会议为期 4 天, 将有来自近 20 个国家和地区的代表参加。会议将通过展览展示、专题讲座、特邀报告、主题论坛、分会报告、论文张贴等形式交流电子封装技术领域的最新进展, 感受其无穷的魅力。大会诚邀您的参与, 共襄盛举!

#### 一、大会主要信息

##### 专题讲座:

1. 听课注册: 2020 年 8 月 11 日
2. 讲座日期: 2020 年 8 月 12 日

会议地点: 中国 广州

会议官方网站: <http://www.icept.org> Email: [icept2020@gdut.edu.cn](mailto:icept2020@gdut.edu.cn)

##### 摘要及论文提交:

~~2020 年 3 月 20 日, 摘要投稿截止日期;~~ **2020 年 4 月 4 日, 摘要投稿截止日期;**  
**2020 年 4 月 17 日, 摘要接收通知日期;** 2020 年 5 月 20 日, 全文投稿截止日期;  
2020 年 6 月 10 日, 全文接收通知日期; 2020 年 6 月 20 日, 全文终稿截止日期。

会议规模: 450-500 人

##### 大会:

1. 现场注册: 2020 年 8 月 12 日
2. 会议时间: 2020 年 8 月 12-15 日

## 二、会议专题

- ◇ **先进封装：**2.5 和 3D 封装，晶圆级/板级封装，倒装芯片，先进封装基板技术，系统级集成，异质异构集成，封装设计和工艺研发。
- ◇ **封装材料与工艺：**新型封装材料，绿色材料，纳米材料，以及用于封装/组装工艺相关的封装材料。
- ◇ **封装设计、建模与仿真：**系统集成封装设计、建模、算法与仿真，电/热/光/机械特性建模、算法与仿真，多尺度和多物理场建模，工艺仿真。
- ◇ **互连技术：**TSV，凸点和微铜柱技术，高密度互连技术，纳米材料键合，转接板，扇出和扇入封装再布线，芯片-晶圆/面板和晶圆-晶圆互连技术，热压焊，非传统互连技术。
- ◇ **封装制造技术与设备：**封装和组装工艺总的组装、测试、制造和自动化技术与设备，在线测量与表征技术与设备。
- ◇ **质量与可靠性：**封装测试技术，质量检测与评估，可靠性数据采集和分析方法，可靠性仿真，寿命预测，失效分析和无损检测等。
- ◇ **功率电子：**功率电子器件的热管理、互连和基板技术，开关模组，隔离/非隔离电源，逆变模块，IPM，POL，PwrSoC，PSiP，开放式框架等，电气设计，电磁完整性，控制算法，固件开发，EMI 建模与优化。
- ◇ **光电显示：**光电子和固态照明设计、仿真、互连、封装和集成，新型显示器件、模组封装和组装，MicroLED 巨量转移，可穿戴、可弯曲、可折叠及柔性电子和显示。
- ◇ **微机电与扇出封装：**微/纳机电系统（MEMS/NEMS），传感器封装，植入式器件封装，微流体，纳米电池，3D 打印，自对准和组装。晶圆级/板级扇出封装、扇出封装再布线、扇出封装可靠性、新型扇出封装结构与工艺。
- ◇ **新兴领域封装：**射频/微波和高速 I/O 的新型封装结构及系统的电气建模、分析、设计、集成、制造和表征，计算/通信系统、5G 移动网络、可穿戴/柔性电子和生物电子以及物联网等的组件优化和电源管理。

会议形式：专题讲座、圆桌论坛、大会报告、分会报告、海报张贴、展览展示、最佳论文与海报颁奖等。

## 三、大会秘书组

广东工业大学（省部共建精密电子制造技术与装备国家重点实验室承办）

通信地址：广州番禺大学城广东工业大学工学二号馆；邮编：510006

张 昱： 电话：0086-18344322156 Email: [icept2020@gdut.edu.cn](mailto:icept2020@gdut.edu.cn)

孙 博： 电话：0086-15861887351

尹 雯： 电话：0086-010-82995675

会议注册联系人：

甘凤华： 电话：0086-021-38953725 Email: [faithsh@yeah.net](mailto:faithsh@yeah.net)

张 爽： 电话：0086-010-64655251 Email: [zhangs1189@sina.com](mailto:zhangs1189@sina.com)

会议赞助联系人：

施玥如： 电话：0086-13661508648 Email: [janey.shi@cepem.com.cn](mailto:janey.shi@cepem.com.cn)

Hosted by



Technically Sponsored By



Organized by



廣東工業大學  
Guangdong University of Technology